

C. Standardvorgehensweise III

[6] Befestigung von Wurzelstiften und Stumpfaufbauten

Bei der Verwendung mit "CLEARFIL DC CORE PLUS" ist der Gebrauch von "CLEARFIL DC Activator" nicht erforderlich.

C-1. Isolation und Feuchtigkeitskontrolle

För optimale Ergebniss, ist jegliche Kontamination der zu behandelnden Oberflächen mit Speichel oder Blut zu vermeiden. Um den Zahn sauber und trocken zu halten, empfehlen wir das Anlegen eines Kotterdamms.

C-2. Vorbereitung des Wurzelkanals

Den Wurzelkanal in gewünschter Weise vorbereiten und reinigen.

C-3. Vorbereitung des Stifts

Je nach verwendetem Stift entweder C-3a oder C-3b wählen. Bitte die Gebrauchsinformation des Restaurationmaterials beachten. Sofern nichts anderes vorgeschrieben ist, gilt folgende Empfehlung.

C-3a. Für Glasfaserstifte

K-ETCHANT Syringe auf die Oberfläche des Stifts auftragen. 5 Sekunden lang einwirken lassen, anschließend spülen und trocknen. [ACHTUNG]

- Glasfaserstifte nicht mit Aluminiumoxidpulver sandstrahlen, da dadurch die Stifte beschädigt werden könnten.
- Während der Vorbehandlung und bis zum definitiven Stumpfaufbau jegliche Kontamination der zu behandelnden Flächen vermeiden.

C-3b. Für Metallstifte

Die Häftfläche durch Abstrahlen mit Aluminiumoxidpulver (30 bis 50 µm) bei einem Luftdruck von 0,2-0,4 MPa (29-58 PSI/ 2-4 kg/cm²) anwasen. Der Luftdruck sollte an das Material angepasst werden. Die prothetische Restauration nach dem Abstrahlen 2 Minuten lang mit Ultraschall reinigen und im Anschluss mit einem Luftbläser trocknen.

C-4. Behandlung der Stiftbohrfläche

Das Verfahren in Abhängigkeit vom verwendeten Material auswählen.

C-4a. Bei Verwendung mit CLEARFIL DC CORE PLUS

- Die notwendige Menge BOND unmittelbar vor dem Auftragen in eine Mulde des Mischtablets ausbringen.
- BOND mit dem Applikationspinsel auf die gesamte Stiftbohrfläche auftragen.
- Die gesamte Häftfläche über einen Zeitraum von mehr als 5 Sekunden ausreichend mit einem milden Luftstrom trocknen, bis BOND sich nicht mehr bewegt. Einen Absauger verwenden, um das Verspritzen von BOND zu verhindern. [HINWEIS] Für eine gründliche Trocknung den Luftdruck an Form und Größe der Häftfläche anpassen.

C-4b. Bei Verwendung mit einem anderen dual-/selbsthärtendem Kunststoff-Stumpfaufbaumaterial oder einem anderen dual-/selbsthärtendem Kunststoffzement

- Botte:** Je einen Tropfen BOND und "CLEARFIL DC Activator" in eine Mulde des Mischtablets geben und mit dem Applikationspinsel mischen. [ACHTUNG] Die Lichtschutzplatte verwenden, damit das Material dem Behandlungs- oder Umgebungslicht nicht ausgesetzt wird, und innerhalb von 90 Sekunden nach dem Mischen applizieren. **Unit Dose:** Für diese Verwendung nicht anwendbar.

C-5. Vorbehandlung des Zahns

Je nach gewähltem Verfahren K-ETCHANT Syringe auftragen. Siehe Abschnitt A-4.

C-6. Bonding

Das Verfahren in Abhängigkeit vom verwendeten Material auswählen.

C-6a. Bei Verwendung mit CLEARFIL DC CORE PLUS

- Die notwendige Menge BOND unmittelbar vor dem Auftragen in eine Mulde des Mischtablets ausbringen.
- BOND mit dem Applikationspinsel auf die gesamte zu behandelnde Oberfläche einmassieren. Eine Wartezeit muss nicht berücksichtigt werden. [HINWEIS] Darachten, dass die Behandlungsoberflächen nicht mit Speichel oder Exsudat in Berührung kommen.

C-6b. Bei Verwendung mit einem anderen dual-/selbsthärtendem Kunststoff-Stumpfaufbaumaterial oder einem anderen dual-/selbsthärtendem Kunststoffzement

- Je einen Tropfen BOND und "CLEARFIL DC Activator" in eine Mulde des Mischtablets geben und mit dem Applikationspinsel mischen. [ACHTUNG] Die Lichtschutzplatte verwenden, damit das Material Behandlungs-oder Umgebungslicht nicht ausgesetzt wird, und innerhalb von 90 Sekunden nach dem Mischen verbrauchen.
- Das Gemisch mit dem Applikationspinsel auf die gesamte zu behandelnde Oberfläche einmassieren. Eine Wartezeit muss nicht berücksichtigt werden. [HINWEIS] Darachten, dass die Behandlungsoberflächen nicht mit Speichel oder Exsudat in Berührung kommen.
- Die gesamte Häftfläche über einen Zeitraum von mehr als 5 Sekunden ausreichend mit einem milden Luftstrom trocknen, bis BOND sich nicht mehr bewegt. Einen Absauger verwenden, um das Verspritzen des Gemischs zu verhindern. Überschüssiges BOND mit einer Papierspitze entfernen. Nach dem Entfernen von überschüssigem BOND die Häftfläche ggf. erneut trocknen. [HINWEIS] Für eine gründliche Trocknung den Luftdruck an Form und Größe der Häftfläche anpassen.
- BOND mit einem Polymerisationsgerät lichthärten (siehe Tabelle "Polymerisationsgerät und Aushärtungszeit").

C-7. Platzieren des Stifts und Stumpfaufbau

Den Stift und Stumpfaufbau mit "CLEARFIL DC CORE PLUS" oder einem anderen Kunststoff gemäß den Anweisungen des Herstellers platzieren.

D. Standardvorgehensweise IV

[7] Befestigung indirekter Restaurationen

Bei Verwendung mit "PANAVIA SA Cement Plus" ist der Gebrauch von "CLEARFIL DC Activator" nicht erforderlich.

D-1. Vorbehandlung der Kavitäten- oder Stumpfoberflächen (Zahn, Metall, Composite)

- Provisorisches Füllungsmaterial und provisorisches Zement in der üblichen Weise entfernen. Kavität reinigen und anschließend gut trocknerhalten.
- Restauration einpassen und Passung auf Kavität oder Stumpf (Zahnsubstanz, Metall, Composite) prüfen. Bei Verwendung einer Try-in-Paste zur Überprüfung der Farbe die Herstelleranweisungen beachten.

D-2. Oberflächenvorbereitung prothetischer Restaurationen

Je nach Restauration entweder D-2a oder D-2b wählen. Die Gebrauchsinformation des Restaurationmaterials beachten. Sofern nichts anderes vorgeschrieben ist, gilt folgende Empfehlung.

D-2a. Für Glaskeramiken auf Basis von Siliziumdioxid (z. B. konventionelles Porzellan, Lithiumdisilikat)

Die Glaskeramikoberflächen mit Flusssäure gemäß Herstelleranweisung ätzen und Oberfläche gründlich waschen und trocknen.

D-2b. Für Metalloxydkeramiken (z. B. Zirkonoxid), Metalle oder Composite-Kunststoffe

Die Häftfläche muss durch Abstrahlen mit Aluminiumoxidpulver (30 bis 50 µm) bei einem Luftdruck von 0,2-0,4 MPa (29-58 PSI/ 2-4 kg/cm²) angeraut sein. Der Luftdruck sollte an das Material und/oder die Form der prothetischen Restauration angepasst worden sein; darauf achten, dass keine Abplatzungen aufgetreten sind. Die prothetische Restauration muss nach dem Abstrahlen 2 Minuten lang mit Ultraschall gereinigt und im Anschluss im Luftstrom getrocknet worden sein.

D-3. Vorbehandlung der prothetischen Restaurationen

Das Verfahren in Abhängigkeit vom verwendeten Material auswählen.

D-3a. Bei Verwendung mit PANAVIA SA Cement Plus

- Die notwendige Menge BOND unmittelbar vor dem Auftragen in eine Mulde des Mischtablets ausbringen.
- BOND mit dem Applikationspinsel auf die gesamte Häftfläche auftragen.
- Die gesamte Häftfläche über einen Zeitraum von mehr als 5 Sekunden ausreichend mit einem milden Luftstrom trocknen, bis BOND sich nicht mehr bewegt. Einen Absauger verwenden, um das Verspritzen von BOND zu verhindern. [HINWEIS] Für eine gründliche Trocknung den Luftdruck an Form und Größe der Häftfläche anpassen. Für eine optimale Wirkung kann anstelle von BOND ein Silanahaftvermittler (z. B. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS) gemäß den Anweisungen des Herstellers auf die Oberfläche der Glaskeramik auf Siliziumdioxidbasis (z. B. konventionelles Porzellan, Lithiumdisilikat) aufgetragen werden. Das Auftragen von BOND auf Metalloxydkeramiken oder Metalle ist nicht nötig, da „PANAVIA SA Cement Plus“ stark an diesen Oberflächen haftet.

D-3b. Bei Verwendung mit einem anderen dual-/selbsthärtendem Kunststoffzement

- Botte:** Je einen Tropfen BOND und "CLEARFIL DC Activator" in eine Mulde des Mischtablets geben und mit dem Applikationspinsel mischen. [ACHTUNG] Die Lichtschutzplatte verwenden, damit das Material Behandlungs- oder Umgebungslicht nicht ausgesetzt wird, und innerhalb von 90 Sekunden nach dem Mischen verbrauchen. **Unit Dose:** Für diese Verwendung nicht anwendbar.

D-4. Vorbehandlung des Zahns

Je nach Verfahren ggf. K-ETCHANT Syringe auftragen. Siehe Abschnitt A-4.

D-5. Bonding

Das Verfahren in Abhängigkeit vom verwendeten Material auswählen.

D-5a. Bei Verwendung mit PANAVIA SA Cement Plus

- Die notwendige Menge BOND unmittelbar vor dem Auftragen in eine Mulde des Mischtablets ausbringen.
- BOND mit dem Applikationspinsel auf die gesamte Kavitätewand einmassieren. Eine Wartezeit muss nicht berücksichtigt werden. [HINWEIS] Darauf achten, dass die Behandlungsoberflächen nicht mit Speichel oder Exsudat in Berührung kommen.

D-5b. Bei Verwendung mit einem anderen dual-/selbsthärtendem Kunststoffzement

- Je einen Tropfen BOND und "CLEARFIL DC Activator" in eine Mulde des Mischtablets geben und mit dem Applikationspinsel mischen. [ACHTUNG] Die Lichtschutzplatte verwenden, damit das Material Behandlungslicht oder Umgebungslicht nicht ausgesetzt wird, und innerhalb von 90 Sekunden nach dem Mischen verbrauchen.

D-6. Zementierung

Die Restauration mit "PANAVIA SA Cement Plus" oder einem anderen Kunststoffzement gemäß den Anweisungen des Herstellers zementieren.

D-6a. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Licht („Lack-Cure“)

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Lichthärtung des Zements verkürzen.

D-6b. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Wärme

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Wärmehärtung des Zements verkürzen.

D-6c. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Druck

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Druckhärtung des Zements verkürzen.

D-6d. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Vibration

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Vibrationhärtung des Zements verkürzen.

D-6e. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Ultraschall

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Ultraschallhärtung des Zements verkürzen.

D-6f. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Laser

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Laserhärtung des Zements verkürzen.

D-6g. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Infrarot

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Infrarot-Härtung des Zements verkürzen.

D-6h. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Mikrowellen

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Mikrowellen-Härtung des Zements verkürzen.

D-6i. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Radiofrequenz

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Radiofrequenz-Härtung des Zements verkürzen.

D-6j. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Ultraschall

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Ultraschall-Härtung des Zements verkürzen.

D-6k. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Laser

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Laser-Härtung des Zements verkürzen.

D-6l. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Infrarot

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Infrarot-Härtung des Zements verkürzen.

D-6m. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Mikrowellen

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Mikrowellen-Härtung des Zements verkürzen.

D-6n. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Radiofrequenz

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Radiofrequenz-Härtung des Zements verkürzen.

D-6o. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Ultraschall

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Ultraschall-Härtung des Zements verkürzen.

D-6p. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Laser

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Laser-Härtung des Zements verkürzen.

D-6q. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Infrarot

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Infrarot-Härtung des Zements verkürzen.

D-6r. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Mikrowellen

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Mikrowellen-Härtung des Zements verkürzen.

D-6s. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Radiofrequenz

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Radiofrequenz-Härtung des Zements verkürzen.

D-6t. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Ultraschall

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Ultraschall-Härtung des Zements verkürzen.

D-6u. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Laser

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Laser-Härtung des Zements verkürzen.

D-6v. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Infrarot

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Infrarot-Härtung des Zements verkürzen.

D-6w. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Mikrowellen

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Mikrowellen-Härtung des Zements verkürzen.

D-6x. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Radiofrequenz

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Radiofrequenz-Härtung des Zements verkürzen.

D-6y. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Ultraschall

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Ultraschall-Härtung des Zements verkürzen.

D-6z. Bei Anwendung der Initial-Anhärtung durch Laser

verkürzt sich die Abbindezeit des überschüssigen Zements. BOND oder das Gemisch aus BOND und „CLEARFIL DC Activator“ kann die Laser-Härtung des Zements verkürzen.

D-7. Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

[REC-TP] Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Str. 4, 65795 Hattersheim am Main, Germany Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 840

SVENSKA BRUKSANVISNING

I. INTRODUKTION

"CLEARFIL Universal Bond Quick" består av BOND och K-ETCHANT Syringe. BOND är ett ljusthärdande bindningsmedel som tillåter en samtidig behandling av dentin, emalj och protetikmaterial. Beredande på indikation, används BOND vid självsättnis eller tillsammans med K-ETCHANT Syringe för selektiv emaljetätning eller totalt teknisk. BOND är avsedd att användas för både direkta och indirekta restaurationer. "CLEARFIL DC Activator" tillåts för att göra BOND dualhärdande, och krävs ingen tillsatts av "CLEARFIL DC Activator" till BOND då det används tillsammans med "CLEARFIL DC CORE PLUS" eller "PANAVIA SA Cement Plus". BOND finns att tillgå i både Botte och Unit Dose engångspåsar. K-ETCHANT Syringe är en etsgel som består av 35 % fluorosyra i en vattenbaserad lösning och kolloidalt kiseldioxid.

II. INDIKATIONER

"CLEARFIL Universal Bond Quick" används vid följande indikationer: [1] Direkta restaurationer med ljusthärdande kompositmaterial [2] Tätning av kavitetföresegling som förbehandling vid indirekta restaurationer [3] Behandling av exponerade rottor [4] Behandling av hypersensibla tänder [5] Intraorala reparationer av frakturerade restaurationer [6] Centering av tandplåtar och pelaruppbyggnad [7] Centering av indirekta restaurationer

III. KONTRAINDIKATIONER

Patienter med överkänslighet mot metakrylater, och som tidigare reagerat vid behandling med denna produkt

IV. MÖJLIGA BIEFFEKTER

[1] Vid kontakt med BOND kan viktiga misstärkning av slemlinhan uppstå p.g.a. proteinkoagulation. Detta är ett tillfälligt fenomen som normalt försvinner inom några få dagar. [2] Ljuparna patienten till försiktighet vid den dagliga munhygien. [3] K-ETCHANT Syringe kan förorsaka inflammation eller erosion pga kemikalieinnehåll.

V. INKOMPATIBILITET

[1] Använd inga eugenolhaltiga material som skydd för pulpan eller som provisorisk tätning, eftersom eugenol kan fördröja härdningsprocessen. [2] Använd inte hemostatika med järnhaltiga komponenter, eftersom dessa material kan påverka adhesion negativt, och orsaka misstärkning av både kantanslutning och omgivande tandkött på grund av kvarvarande järnrester. [3] Vid användning av blodstånande medel, som innehåller aluminiumklorid, ska så lite material som möjligt användas, var försiktig för att undvika kontakt med vidhäftningsytan. Om medlet hamnar på den vidhäftande ytan, kan detta förorsaka vidhäftningsförmågan mot tandstrukturen.

VI. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Säkerhetsanvisningar

- Den här produkten innehåller ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner. Undvik att använda produkten på patienter med känd allergi mot metakrylatmonomerer eller någon av de andra komponenterna.
- Om patienten får en överkänslighetsreaktion som t.ex utslag, eksem, inflammationer, sår, svullnader, klåda eller domningar ska behandlingen med produkten avbrytas, produkten tvättas av och en läkare konsulteras.
- Var försiktig vid användning av produkten och undvik kontakt med hud och ögon. För användning av produkten ska patientens ögon täckas över med en handduk för att skydda dem mot materialslakt.
- Om produkten kommer i kontakt med kroppsvävnad ska följande åtgärder vidtas: <Om produkten hamnar i ögonen>: Skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare. <Om produkten kommer i kontakt med huden eller slemlinnan>: Torka omedelbart av med en bomullstuss eller en tork av gasväv fuktad med alkohol, och skölj därefter med rikliga mängder vatten.
- Var försiktig så att patienten inte sväljer produkten.
- Undvik att titta direkt in i ljustrålen medan BOND ljusthärdas.
- Undvik att återandvända BOND omedelbart i blandningskålen och som redan använts en gång. Använd inte heller samma Unit DOSE kapsel eller engångspensel till olika patienter för att undvika korskontaminering. Dessa är avsedda för engångsbruk och ska kastas efter användning. Kanylen får endast användas en gång. För att undvika korskontaminering ska kanylen inte återanvändas. Släng kanylen efter användning.
- Bär handskar eller vita andra försiktighetsåtgärder för att förebygga en överkänslighet som kan uppstå vid hantering av metakrylatmonomerer eller någon av de övriga komponenterna.
- Om instrumenten till denna produkt är skadade, se till att du inte skadar dig själv och sluta genast att använda dem.

2. Försiktighetsåtgärder vid hantering [Normala försiktighetsåtgärder]

- Produkten får inte användas för andra ändamål än de som anges i [II.INDIKATIONER] (bruksanvisningen)
- Denna produkt får endast användas av legitimerade tandläkare.
- Om nödvändigt gör en pulpaöverkapping.

[BOND]

- BOND innehåller etanol som är en lättantändlig substans. BOND får inte användas i närheten av öppen eld.
- För att undvika dålig bindning eller hantering, ska de specificerade ljusthärdningstiderna och andra hanteringskrav iaktas.
- Rengör kaviteten tillräckligt för att undvika dålig adhesion. Om bondingsytan är kontaminerad med saliv eller blod, ska den rengöras ordentligt och torkas innan bondingen påbörjas.

4. Botte: Använd en ljustöckningsplatta för att undvika att materialet utsätts för operationsbelysning eller allmänbelysning och använd produkten inom den arbetstid som anges nedan efter dosering eller bländning.

	Material	Arbetstid
	BOND	7 minuter
	BOND + CLEARFIL DC Activator	90 sekunder

BOND innehåller etanol vilket medför att viskositeten ökar när etanolet avdunstar, detta gör materialet svårapplicerat.

Unit Dose: Applicera BOND med engångspenseln omedelbart efter locket har avlägsnats.

5. Under appliceringen av BOND på vidhäftningsytan med gnidande rörelse, ska ljuskålen flyttas ut ur munnen eller lampen släckas, för att undvika att applicerad BOND exponeras för ljuset. Dessutom ska vidhäftningsytan torkas ordentligt med mild tryckluft, efter applicering av BOND tills BOND är fast.

6. BOND innehåller etanol och vatten. "CLEARFIL DC Activator" innehåller etanol. Torka hela vidhäftningsytan ordentligt med mild tryckluft i minst 5 sekunder, tills BOND eller bländningen av BOND och "CLEARFIL DC Activator" är fast, eftersom vidhäftningsförmågan annars försämras. För att uppnå tillräckliga torkningsresultat, ska lufttrycket anpassas till kavitetens form och storlek och den protetiska restaureringen. Använd sugen för att förhindra att BOND eller bländningen sprids ut.

7. Om den behandlade ytan är kontaminerad ska den tvättas av med vatten, torkas eller rengöras med alkohol och sedan behandlas med BOND igen.

8. **Botte:** Blanda inte BOND med andra bindningsmedel förutom "CLEARFIL DC Activator".

Unit Dose: Använd inte BOND med andra bindningsmedel. Använd inte Unit Dose med CLEARFIL DC Activator som följd av Unit Dose-behållarens konstruktion.

9. **Unit Dose:** Vid användning för pelaruppbyggnad eller centering, använd BOND endast med "CLEARFIL DC CORE PLUS" eller "PANAVIA SA CEMENT Plus".

10. **Botte:** Ljusthärd bländningen av BOND och "CLEARFIL DC Activator". Annars kommer arbetstiden att förkortas dramatiskt.

11. **Botte:** Förpackningen ska återförslutas omedelbart efter användning för att minska avdunstning av lättflyktiga lösningsmedel (innehåller etanol). Om inte flasken innehåll till rinner ut ur öppningen, får inte överväldigt användas, rengör den tilltåpta öppningen istället.

12. **Botte:** Om BOND inte används under en längre tid, kan vätskan eventuellt vara trögflytande. Skaka då flaskan före användning.

[K-ETCHANT Syringe]

1. Var nogga med att inte förörena den med saliv eller blod. Om den behandlade ytan är frörentad måste den behandlas igen.

2. Var nogga med att förhindra korskontaminering. Desinficera sprutan före och efter användning med en bomullstuss som är indränkt i alkohol. Täck över hela sprutan med ett engångsplastskydd för att förhindra kontaminering med saliv och blod.

3. Om produkten hamnar på kläder, ska dessa sköljas med vatten.

4. Efter varje användning ska kanylen avlägsnas från sprutan och sprutan omedelbart återförslutas med locket.

5. Etsning av vitlät dentin kan ge postoperativ känslighet.

[Hårdjustampa]

1. Låg ljusstyrka förorsakar en dålig adhesion. Kontrollera lampans livslängd och hårdhetsnivån. LJUSTYRKA. Vi rekommenderar att jämna mellanrum kontrollera hårdjustampans ljusstyrka.

2. Ljustidens hårdjustampa måste hållas vertikell mot- och ska nära komponents yta som möjligt. Om en stor yta ska hårdas, rekommenderar vi att ytan delas in i flera områden som ljusthärdas var och en för sig.

3. Säkerhetsanvisningar för förvaringen

- Produkten måste användas innan förfallotdatum som står på förpackningen.
- BOND ska förvaras i kyl (2-8°C/ 36-46°F) när den inte används, och ska förvaras i rumtemperatur i 15 minuter innan den används, så att den återfår normal konsistens. I synnerhet, Botte måste stå stills den lått rumtemperatur, i annat fall kan bubblor uppstå i vätskan under användning eller komma till ytan efter användning.
- K-ETCHANT Syringe ska förvaras i 2 -25°C/ 36 - 77°F när den inte används.
- Produkten får inte utsättas för extrem heta, direkt solsken eller öppen eld.
- Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är åtkomlig för tandvårdspersonalen.

VI. KOMPONENTER

Se förpackningens utsida för information om innehåll och mängd. <Ljustyrdreglerare>

- BOND
 - 10-Metakryloyloxydetyldivalefostat
 - Bisfenol A diglycidyletyletarylat
 - 2-Hydroxyetylmetakrylat
 - Hydrofil amid-monomer
 - Kolloidalt kiseldioxid
 -